

大会スポンサー募集 (2/6申込締切)

Aタイプ 費用：10万円

- 特典1：大会Webページ，会場スクリーン，会場で配付するパンフレット裏表紙へのロゴ表示
- 特典2：聴講無料参加枠（2名，オンライン聴講可能）
- 特典3：会場で配布する学会バッグにロゴ掲載。ただし印刷色は単色・指定色のみ（ご希望により）
- 特典4：会場で配付するパンフレット（A4判1頁，白黒）への広告掲載（ご希望により）

Bタイプ 費用：5万円

- 特典1：大会Webページ，会場スクリーン，会場で配付するパンフレット裏表紙へのロゴ表示
- 特典2：聴講無料参加枠（1名，オンライン聴講可能）
- 特典3：会場で配付するパンフレット（A4判1頁，白黒）への広告掲載（ご希望により）

学会バッグ
イメージ



指定色



※Webページ，パンフレット，バッグへのロゴの掲載順は申込順とさせていただきます。

お申し込み・問い合わせ先：川崎（kawasaki@jsme.or.jp）

日本機械学会
情報・知能・精密機器(IIP)部門講演会
(生産システム部門(MSD)研究発表講演会
とコロケーション開催)

1. 開催時期：2023年3月6, 7日
2. 開催形式：ハイブリッド
3. 開催場所：九州工業大学戸畑キャンパス
4. 参加人数：約250名（講演件数約140件）
5. 参加者層：大学教員，学生，企業研究者

講演会趣旨

本講演会では、情報機器・精密機器・医療機器に関して、センサ・アクチュエータなどの機構制御技術，小型・高密度なエネルギー技術，AI・自動化などの智能化技術などの広い分野を取り上げます。部門を超えた広い視点での議論を促進するため，本講演会は生産システム部門研究発表講演会2023（MSD2023）と同時開催いたします。本講演会が，情報・知能・精密機器技術に関わる研究者・技術者の最大の交流・情報交換の場となるよう，多くの方々の参加を期待します。

情報・知能・精密機器部門講演会 OS一覧

(A) ヘッド・ディスク・インターフェイスとトライボロジー
(B) 情報機器コンピュータメカニクス
(D) フレキシブル体のハンドリングと高機能化技術
(E) マイクロナノメカトロニクス
(F) 医療・福祉・ヘルスケアに関するテクノロジー
(G) メカニカルシステムとその智能化 / 家庭・業務用電化機器
(H) マイクロナノ理工学
(I) IoTと情報・知能・精密機器 / 機械・インフラの保守・保全・信頼性強化
(J) プリントブル・ウェアラブルデバイスの基盤技術と応用
(K) DX時代の非破壊センシングとデータ活用－NDE4.0の実現に向けて (日本非破壊検査協会連携セッション)